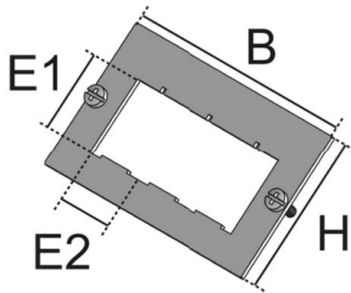


UDEP COR

platine voor datatechniek

Inbouwplatine van aluminium, met zwarte coating. Voor inschroeven in een data-toestel drager. Voor aansluiten van datajacks.



materiaal	Aluminium, eenzijdig met zwarte coating
montagewijze	schroefbaar
toepassingsgebied	toestelbeker data
opname voor fabrikant	Corning: LANscape S250 Module RJ45 Cat. 6 Corning: LANscape S500 Module RJ45 Cat. 6A

Aluminium

Product	H	B	E1	E2	mechanismen	G
UDEP-COR 3	46 mm	75 mm	22,8 mm	18 mm	3	0,03 kg

H: hoogte
B: breedte
E1: inbouwmaat
E2: inbouwmaat
mechanismen: max. aantal installeerbare datajacks
G: gewicht

OPTIONELE TOEBEHOREN

UGETD

